

产品说明书

WS3500型倒装片助焊剂

特点

- 可溶于水
- 不含卤化物
- 适于喷雾或浸渍
- 适于锡铅，无铅和高铅合金的焊接
- 对锡球凸块下的金属化表面无侵蚀作用

简介

WS3500型倒装片助焊剂 是一种液态助焊剂，用于小间距（小于0.5mm）倒装片的直接贴装。它的残留物可以用水清洗干净，解决了与底部填充材料的兼容性问题。

特性

特性	测试值	测试方法
助焊剂类型	M0	J-STD-004 (IPC-TM-650)
典型粘度	60cst	Brookfield
表面绝缘电阻 (欧姆, 清洗后)	合格(在温度为85°C、相对湿度为85%的条件下, 7天以后>109)	IPC-B-24 2.6.3.3
颜色	介于深琥珀色和黄色之间	直接观察
保质期	在-25°C到-10°C下可保存6个月	粘度变化或用显微镜检查

所有信息仅供参考。不用作未来产品的规范。

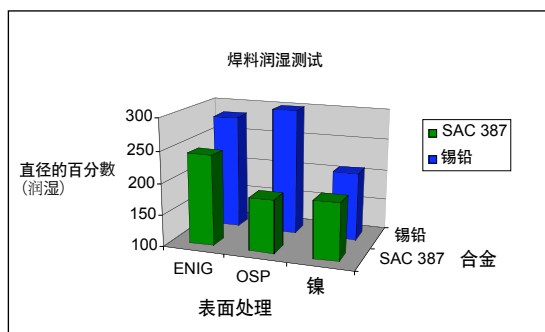
使用

推荐剂量: 推荐剂量为500-1500微克/平方毫米，取决于倒装片的种类。

对于喷雾式涂敷: 喷雾器中助焊剂储存罐应当贮有足够8小时的用量。罐内剩余的助焊剂如果存放时间过长会失效（在室温下可在罐内存放10小时以下）。喷雾器需要经常清洗，才能保证涂敷均匀以及助焊剂的纯净度。



焊料润湿能力的比较



接反面→

Form No. 98244(SC A4) R1

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
美国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册

WS3500型倒裝片助焊剂

清洗

本材料可用去离子水或者加了清洗剂的水來清洗。喷淋清洗的理想条件: 25°C (室温) 或更高, 时间 >1 分钟, 压力 >60psi。

包装

100克到3.8公升 (1加仑) 罐裝。可根据具体要求提供其他规格包装。

储存

WS3500的存放温度为零下25到零下10°C, 保质期可以达到最长。在25°C的环境里存放时间不可以超过4天。储藏温度不可以超过30°C。WS3500从冷藏环境移到室温后, 在使用前应在室温下放置至少4小时。

技术支持

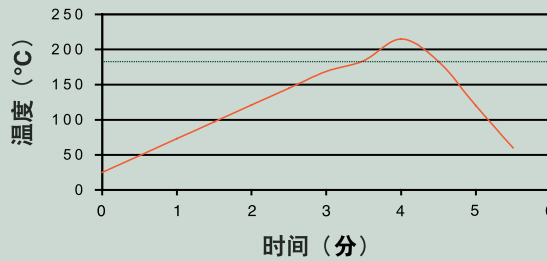
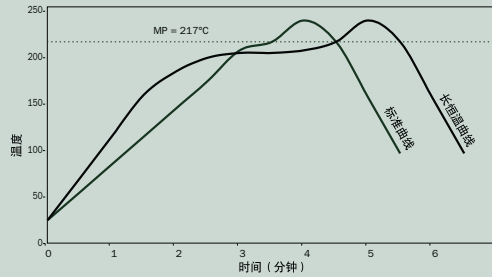
Indium Corporation 树立了为全球客户迅速提供现场技术支持的业界标准。Indium 公司的技术支持工程师队伍可提供材料科学和半导体封装工艺应用领域的各方面专业知识。

材料安全数据

关于本产品的材料安全数据 (MSDS), 请上网查阅, 网址: <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

回流

推荐的工作曲线:



再流焊

在空气或氮气 (氧气含量 <100ppm) 中进行再流焊时, 温度先直线上升到比液相线温度高 30°C, 再流的最高温度应 <340°C。我们建议用户从这些温度曲线开始, 根据工艺的需要对它进行优化。

此资料只是一般信息。不能保证或担保这些资料所述产品的性能, 也不可以把这些资料看作是对所述产品的保证或担

保。售出的产品只承诺随产品包装及发票所附的书面保证及有关的限制条件。

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
英国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册